

Title (en)

PHENOLIC TYPE RESIN CONTAINING FORMAMIDE FOR LOW PRESSURE LAMINATION.

Title (de)

FORMAMID ENTHALTENDES PHENOLHARZ FÜR NIEDERDRUCK-LAMINATE.

Title (fr)

RESINE DU TYPE PHENOLIQUE CONTENANT DE LA FORMAMIDE POUR UN LAMINAGE A BASSE PRESSION.

Publication

**EP 0136344 A1 19850410 (EN)**

Application

**EP 84901247 A 19840217**

Priority

- US 46854783 A 19830222
- US 57818184 A 19840214

Abstract (en)

[origin: WO8403293A1] A fast-curing, phenolic laminating resin comprising a resole resin in an organic solvent, about 2 to 15% of a material selected from the group consisting of formamide, N-methyl formamide, N,N-dimethyl formamide, N-ethyl formamide, N,N-diethyl formamide, N,N-diphenyl formamide and N-methyl formanilide, and a catalytic amount of an inorganic alkaline material. The laminating resin exhibits sufficiently high penetration and curing characteristics for use in a low pressure, continuous laminating process.

Abstract (fr)

Résine phénolique de laminage à polymérisation rapide comprenant une résine de résol dans un solvant organique, 2 à 15 % environ d'un matériau sélectionné dans le groupe se composant de formamide, N-méthyl formamide, N,N-diméthyl formamide, N-éthyl formamide, N,N-diéthyl formamide, N,N-diphényl formamide et N-méthyl formanilide, ainsi qu'une quantité catalytique d'un matériau alcalin inorganique. La résine de laminage présente des caractéristiques de pénétration suffisamment élevées et de polymérisation rapide, permettant de l'utiliser dans un procédé de laminage en continu à basse pression.

IPC 1-7

**C08L 61/06**; **D21H 3/02**; **B32B 27/04**

IPC 8 full level

**B32B 27/04** (2006.01); **C08K 5/20** (2006.01); **D21H 17/48** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B32B 27/04** (2013.01 - EP); **B32B 27/12** (2013.01 - US); **B32B 38/164** (2013.01 - US); **C08K 5/20** (2013.01 - EP); **D21H 17/48** (2013.01 - EP); **B32B 2451/00** (2013.01 - US)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

**WO 8403293 A1 19840830**; EP 0136344 A1 19850410

DOCDB simple family (application)

**US 8400215 W 19840217**; EP 84901247 A 19840217